

1-2041145-2 ✓ 有效



HPI

TE 内部编号 1-2041145-2

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 12 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, Signal, HPI

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 2.0 mm Headers



连接器系统: **线到板**

位数: 12

行数: 1

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: **直角**

[所有 AMP HPI 2.0 mm Headers \(205\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 线到板 |
| 接头类型 | 部分带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 位数 | 12 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 直角 |

电气特征

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

| | |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

| | |
|---------|-------------------|
| 端子接触部长度 | 3.35 mm [.131 in] |
|---------|-------------------|



| | |
|--------------------|------------------|
| 接合方柱尺寸 | .5 mm[.02 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2.03 μm[80 μin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 2.032 μm[80 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| 端子形状和构造 | 正方形 |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A |
| 端接特性 | |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .5 mm[.02 in] |
| 每个柱体的端接数 (最大值) | 3 |
| 端接柱体和尾部长度 | 3.4 mm[.134 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
| 机械附件 | |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合固定 | 带有 |
| PCB 安装固定类型 | 弯脚 |
| 接合固定类型 | 锁定 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 带有 |
| 壳体特性 | |
| 外壳材料 | 尼龙 66, 尼龙 66 |
| 中心线 (间距) | 2 mm[.079 in] |
| 尺寸 | |
| 连接器长度 | 26 mm[1.024 in] |
| 连接器高度 | 5.8 mm[.228 in] |
| 连接器宽度 | 7.7 mm[.303 in] |



| | |
|-------------|-----------------------------|
| PCB 厚度 (建议) | 1 – 1.6 mm [.039 – .063 in] |
|-------------|-----------------------------|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -25 – 85 °C [-13 – 185 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 200 |
|------|-----|

| | |
|------|----------|
| 封装方法 | Bag, Box |
|------|----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

| | |
|---|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---|-------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---|

| | |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|

| | |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 波峰焊接可达到 260°C |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

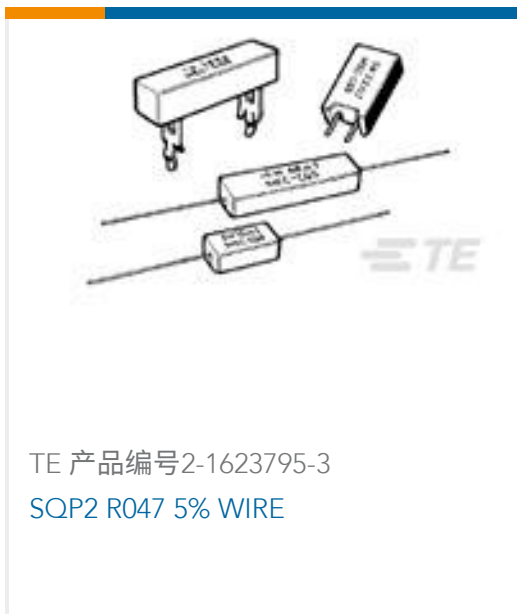
配套部件



该系列中的其他产品 | HPI



客户还购买了



文档

产品图纸

[HPI 2.0MM CONN., R/A, DIP, 12P](#)

英文版本

CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2041145-2_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2041145-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2041145-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本